

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2015-55

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于公司对外投资的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）拟收购宜确半导体（苏州）有限公司（注册地：苏州，以下简称“苏州宜确”）20%的股权。2015年5月4日，长盈精密与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）及苏州宜确签署了《关于投资宜确半导体（苏州）有限公司的意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”），中芯聚源或其关联方将以认缴苏州宜确新增注册资本的方式对苏州宜确进行增资，公司拟使用自有资金以不高于人民币5,000万元的价格收购苏州宜确20%的股权。长盈精密收购苏州宜确股权的估值将以中芯聚源投资意向书的估值为参考，由双方协商确定。

2、前述融资完成后，苏州宜确原股东将持有苏州宜确65%股权，中芯聚源或其关联方将持有苏州宜确15%股权，长盈精密将持有苏州宜确20%股权。

3、本次签订的《意向性协议》仅为投资框架性协议书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，《意向性协议》付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。本意向协议中关于项目的具体实施方案需经长盈精密董事会审议通过后方能生效，协议的具体条款经长盈精密董事会审批后实施。

3、本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

1、长盈精密基本情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司是在中国深圳依法设立并有效存续的股份有

限公司，注册资本为55,575.9036万元，经营范围为生产、销售、开发连接器件、精密五金件、精密接插件（以上不含国家限制项目）及自营进出口业务。

2、中芯聚源的基本情况

中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司是在中国上海合法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为1000万元，由中芯国际集成电路制造（上海）有限公司等股东共同出资成立，专注于集成电路行业的相关领域，通过其管理的基金对产业链中的材料、设计、装备、IP和服务等环节的优质企业进行投资，并为被投资企业提供全面的增值服务。

3、苏州宜确的基本情况

宜确半导体（苏州）有限公司是在中国苏州合法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为1000万元人民币，经营范围为半导体集成电路设计、开发、销售；销售电子产品、计算机软硬件产品，并提供相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事上述商品及技术的进出口业务。

苏州宜确现有股东结构如下：陈俊，认缴出资额650万元，持有目标公司65%的股权；陈高鹏，认缴出资额350万元，持有目标公司35%的股权。

陈俊，2000年获得中国科学院微电子研究所博士学位，2000年至2003年在UCLA高速电子实验室做博士后工作。2004年至2013年在锐迪科（RDA）微电子任高级副总裁。2013年在浙江大学任职特聘研究员。现任苏州宜确CEO。

陈高鹏，2005年本科毕业于中国科学技术大学，2010年获得中国科学院微电子研究所博士学位。2010年3月到2013年10月在锐迪科微电子工作。现任苏州宜确运营总经理。

三、对外投资合同的主要内容

本次公告信息仅为框架性、意向性协议公告，针对本次股权收购相关的具体内容，包括投资金额、支付方式、标的公司董事会和管理人员的组成安排、违约条款、合同的生效条件和生效时间以及合同中的等其他重要条款，长盈精密将与苏州宜确另行签订正式的合同，合同具体条款需经公司董事会审批后实施。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

苏州宜确是专业从事半导体集成电路设计、开发、销售，并提供相关技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务的公司，其核心技术包括智能移动终端的功率放大器与包络跟踪电源系统。这两个核心技术均可以有效提高射频前端的工作效率等技术指标。除前述产品性能优势带给产品本身的极强竞争力外，在成本和供应链安全方面，由于其和关键合作伙伴在先进半导体技术和封装技术开发、良率提升和产能建设上的深度合作，以及积极推进的供应商产业链本土化建设，其产品将具有极高的成本优势和性价比。苏州宜确在集成电路设计、半导体制造上下游也与供应商达成了战略合作关系并与供应商伙伴共同拥有知识产权，且具有这些知识产权的排他性使用权，建立了很高的技术和供应链壁垒。

此次拟收购苏州宜确20%的股权可以在以下两个方面给长盈精密带来新的方向和拓展：

1、基于长盈精密的现有移动智能终端客户资源，参股公司将可以迅速实现，移动智能终端功率放大器芯片及相关产品的推广，迅速扩展销售规模，占领市场；

2、基于参股公司的技术和团队，将拓展无线互联网络射频接入相关产品和物联网相关产品的开发，研制和生产。同时，将积累芯片开发，研制，生产和工艺的经验和技术。为公司未来在智能工厂和工业4.0的无线接入端提供整体方案奠定芯片开发的基础；

3、基于以上合作，长盈精密将为进入芯片，控制，工业4.0等相关国家战略发展领域提供相关的技术储备并积累经验。

本次签订的仅为意向协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。本意向协议中关于项目的具体实施方案需经长盈精密董事会审议通过方能生效，协议的具体条款需经长盈精密董事会审批后实施。长盈精密将按照《深圳市长盈精密技术股份有限公司对外投资管理制度》的规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月五日